



Verpackt + abgefüllt

Verpackungsmaschinen mechatronisch entwickeln

Einladung

zum 6. Forum Mechatronik
im Maschinenbau

am 3. Juni 2008

zu Gast bei FESTO in Esslingen

Mechatronik ein Standortvorteil in der Verpackungstechnik?

Der deutsche Maschinenbau boomt. Maschinen „Made in Germany“ sind weltweit gefragt. Besonders erfolgreich sind die Hersteller von Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Dafür ist maßgeblich die Mechatronik verantwortlich. Das 6. Forum zeigt, wie zukunftsorientierte Verpackungsmaschinen mechatronisch entwickelt werden.



Open Space

Der Nachmittag gehört dem Open Space. Der Open Space ist ein „Klassiker“ auf dem Forum Mechatronik im Maschinenbau. Er schiebt dem „passiven Dabeisein“ einen Riegel vor. Hier lassen sich Meinungen und Beweggründe für die Teilnahme am Forum ideal platzieren. Im Open Space werden Erfahrungen ausgetauscht und Arbeitskontakte geknüpft, die eine besonders lange „Halbwertszeit“ haben, denn Mechatronik verbindet.

Programm

09:30 - 09:45 Empfang durch **Dr. Peter Post**,
Leiter Forschung und Technologie, Festo



Dr. Peter Post, Festo
Leiter Forschung und Technologie

09:45 - 10:00 **Who is who?**
Die Mechatronik Allianz, **Peter Schäfer**, :K



Peter Schäfer
Chefredakteur :K

Moderation: **Dr. Rainer Stetter**,
Geschäftsführer ITQ, Sprecher der Mechatronik Allianz

10:00 - 10:30 **Mechatronik in Verpackungsmaschinen der pharmazeutischen Industrie**
Klaus Hillebrand, Leiter Elektrokonstruktion und Softwareentwicklung,
Bosch Packaging Technology



Dr. Rainer Stetter, ITQ
Geschäftsführer

10:30 - 11:00 **Mechatronik – ein neuer Standard für Verpackungsmaschinen?**
Gerhard Schubert, Geschäftsführer Schubert Verpackungsmaschinen



Klaus Hillebrand, Bosch Packaging Technology
Leiter Elektrokonstruktion und Softwareentwicklung.

11:00 - 11:15 Kaffeepause

11:15 - 11:45 **Flüssig verpacken**
Heinz Hillmann, Produktmanager Competence Center Fülltechnik, KHS



Gerhard Schubert, Schubert Verpackungsmaschinen,
Geschäftsführer

11:45 - 12:15 **Reif für die Mechatronik?**
BestVor – ein Reifegradmodell am Beispiel Verpackungsmaschinen
Dr. Georg Pfeifer, Geschäftsführer Optima Packaging Group



Heinz Hillmann, KHS
Produktmanager Competence Center Fülltechnik

12:15 - 13:45 Mittagessen

13:45 - 16:30 **Open Space**
Moderation: **Paul Kho**, Festo



Dr. Georg Pfeifer, Optima Packaging Group
Geschäftsführer

16:30 - 17:00 Vorstellung der Ergebnisse

17:00 Ende der Veranstaltung



Paul Kho, Festo
Leiter Koordination Technische Fachpresse

(Programmänderungen sind vorbehalten)

Anmeldung

per Fax an **0 81 05 - 38 53 - 11**

Ich melde mich hiermit verbindlich zum 6. Forum Mechatronik im Maschinenbau am 3. Juni 2008 in Esslingen an.
Kostenbeitrag: € 150,- pro Person (einschl. Tagungsunterlagen und Catering, zzgl. gesetzl. MwSt.)

Firma: Name/Vorname:

Abteilung/Funktion: E-Mail:

Straße/Nr.: PLZ/Stadt:

Telefon/Fax: Datum, Unterschrift:

**oder online auf www.maschinenbau-mechatronik.de
oder www.k-magazin.de**

Anmeldeschluss: 19. Mai 2008!

Nach Eingang Ihrer Anmeldung geht Ihnen kurzfristig eine Bestätigung mit Anfahrtsskizze und Hotelverzeichnis zu.

Veranstaltungsort:

FESTO AG & CO. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen

Unterstützt durch:

Diese Veranstaltung wird aktiv von mittelständischen Unternehmen, den Verbänden VDMA und ZVEI sowie den Fachzeitschriften :K, Maschine+Werkzeug, BBR und Automation getragen.

Ansprechpartner:

Jutta Ertl; Henrich Publikationen GmbH
Telefon: +49 (0) 8105 3853 - 23
Fax: +49 (0) 8105 3853 - 11
E-Mail: je@verlag.henrich.de

Organisation:

Paul Kho, Festo
Claus Kühnl, Phoenix Contact, GmbH & Co. KG
Dr. Rainer Stetter, ITQ GmbH
Peter-Michael Synek, VDMA
Peter Schäfer, :K

Veranstalter:

Mechatronik Allianz

Medienpartner:

